

**ULVAC**

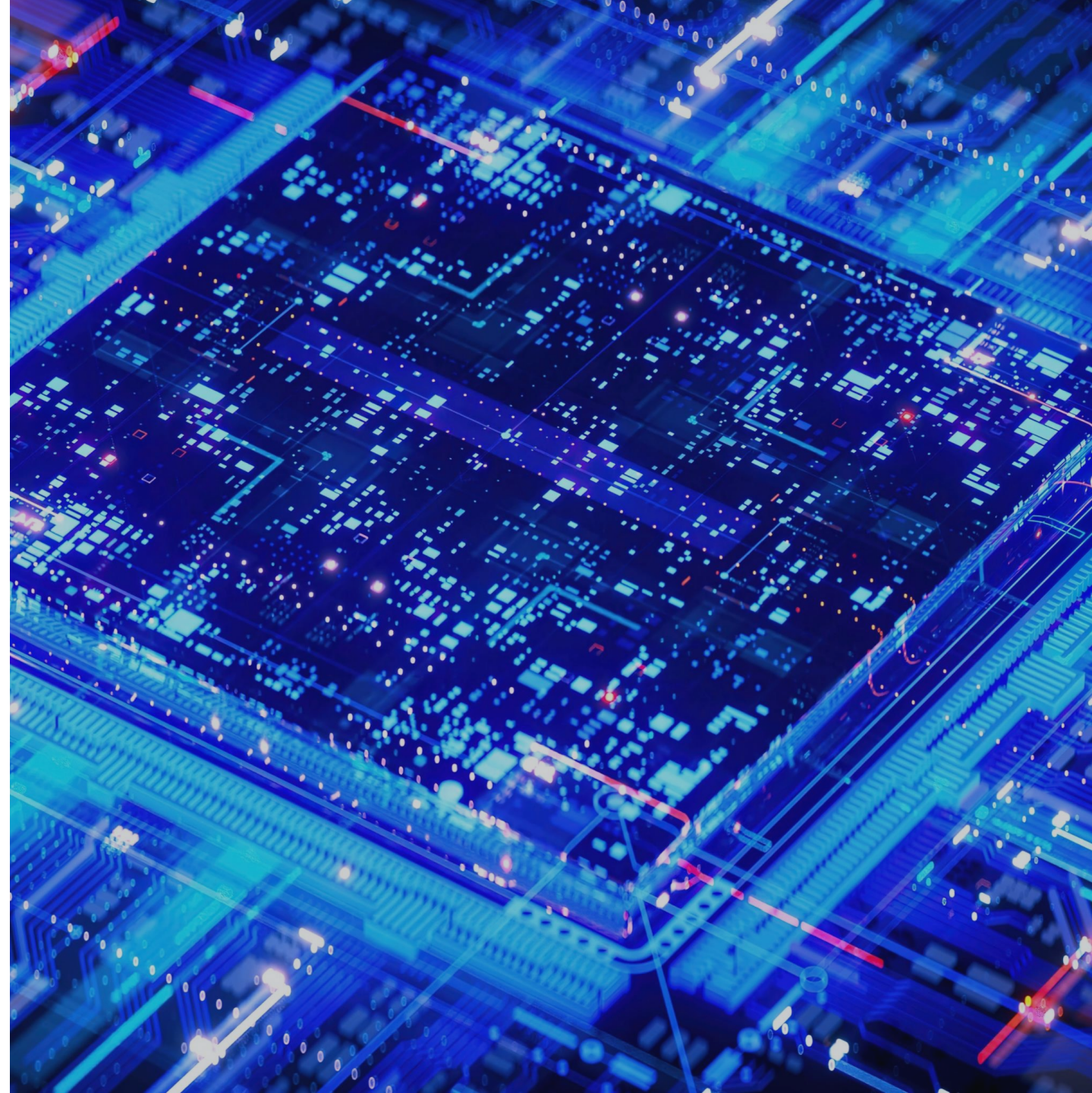
**株式会社 アルバック**

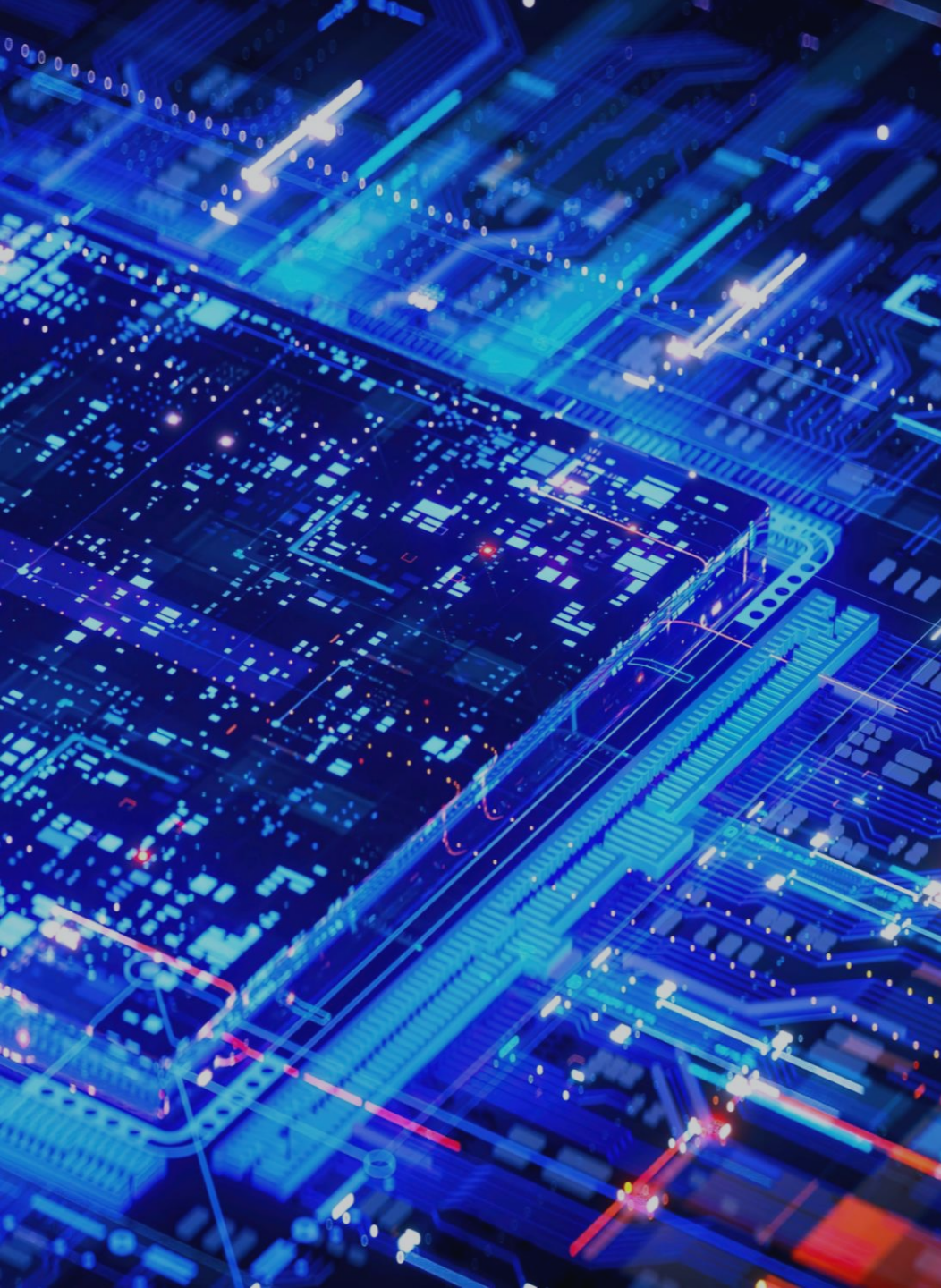
**2024年6月期  
決算説明資料**

---

**2023年7月～2024年6月**

**2024年8月13日**





## 将来見通し等に関する記述についての注意事項

### ■ 将来見通しについて

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

### ■ 数字の処理について

本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。

### ■ 品目名称変更について

FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しました。

## 2024年6月期連結業績

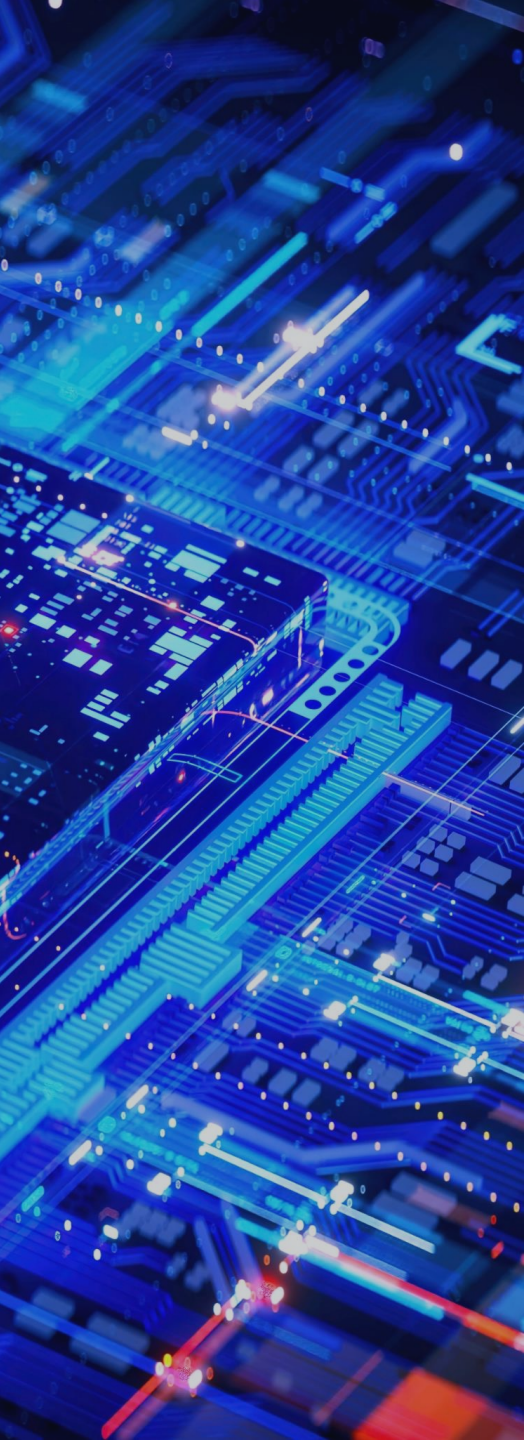
- 受注高・売上高・各利益項目は前年同期・計画を大幅に上回る
- 売上高2,611億円・売上総利益率30.9%は**上場来最高水準**
- 24/6期配当金144円（前回予想比+30円）は**過去最高**

## 2025年6月期連結業績予想

- 受注高2,700億円、売上高2,750億円、営業利益345億円の計画
- 売上総利益率32.4%、営業利益率12.5% を計画

## 中期経営計画

- 26/6期目標に変更なし  
売上高3,000億円、売上総利益率35%、営業利益（率）480億円（16%）
- モノづくり力強化による生産性向上・利益率改善を継続的に推進
- 成長に向けた研究開発投資継続



# 2024年6月期 連結業績

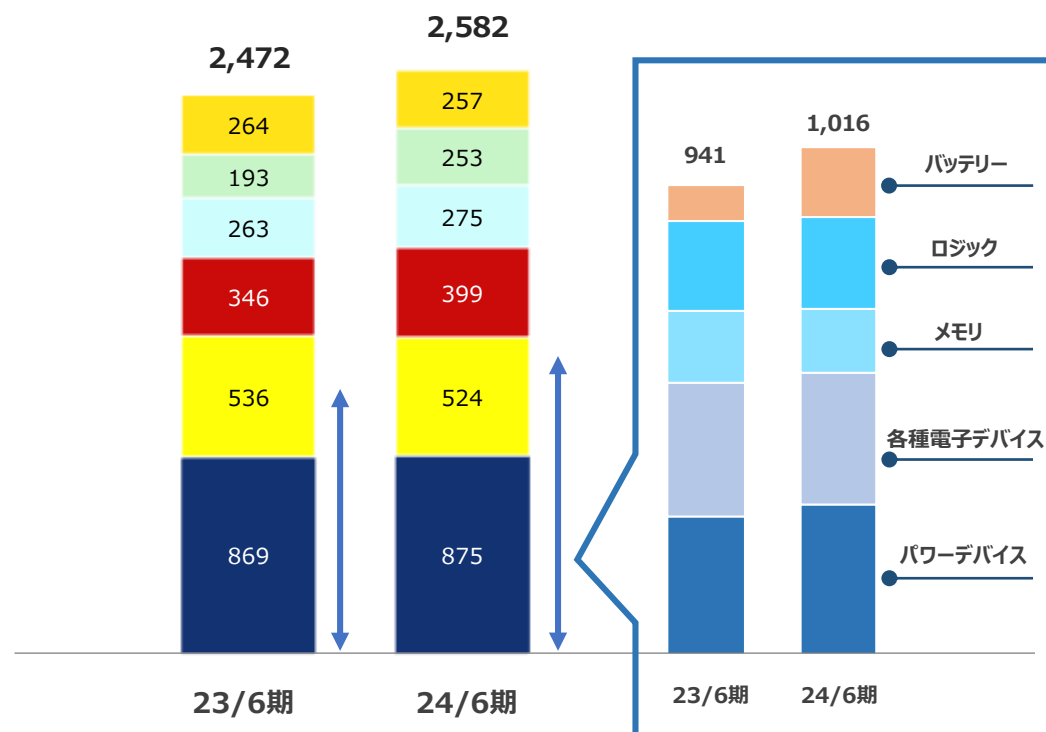
- 受注高・売上高・各利益項目は前年同期・計画を大幅に上回る
- 売上高2,611億円・売上総利益率30.9%は**上場来最高水準**
- 24/6期配当金144円は**過去最高**

【単位：億円】	23/6期 通期実績	24/6期					
		計画値	通期実績	前年同期比		計画比	
				増減	%	増減	%
受注高	2,472	2,500	2,582	+110	+4%	+82	+3%
売上高	2,275	2,450	2,611	+336	+15%	+161	+7%
売上総利益	672	-	807	+135	+20%	-	-
率	29.5%	-	30.9%	+1.4pt	-	-	-
販管費	472	-	509	+37	+8%	-	-
営業利益	199	230	298	+98	+49%	+68	+29%
率	8.8%	9.4%	11.4%	+2.6pt	-	+2.0pt	-
経常利益	229	245	298	+69	+30%	+53	+22%
率	10.1%	10.0%	11.4%	+1.4pt	-	+1.4pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	142	160	202	+61	+43%	+42	+26%
率	6.2%	6.5%	7.7%	+1.5pt	-	+1.2pt	-
一株当たり配当（円）	109		144	+35			

- 受注高：パワーデバイス・バッテリー・材料関連の増加等により、前年同期比増加
- 売上高：受注高増加、高水準の受注残高の寄与等により、2,611億円と上場来最高水準

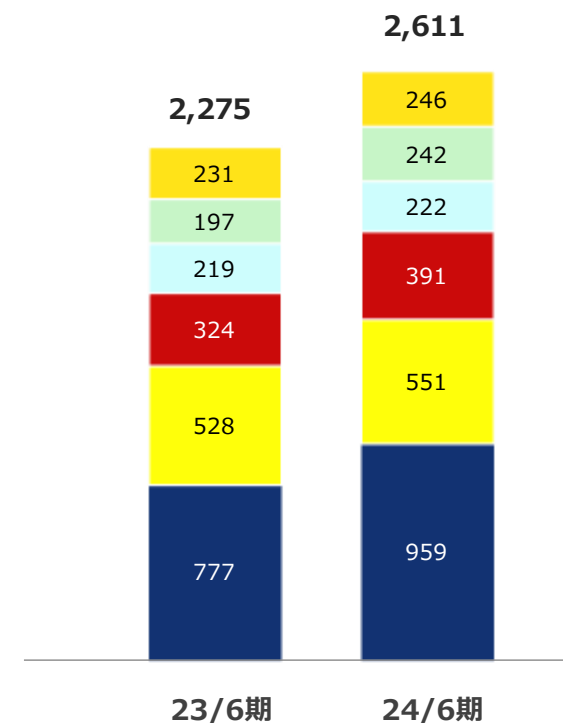
## 受注高【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置    ■ コンポーネント    ■ 材料  
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置    ■ 一般産業用装置    ■ その他



## 売上高【単位：億円】

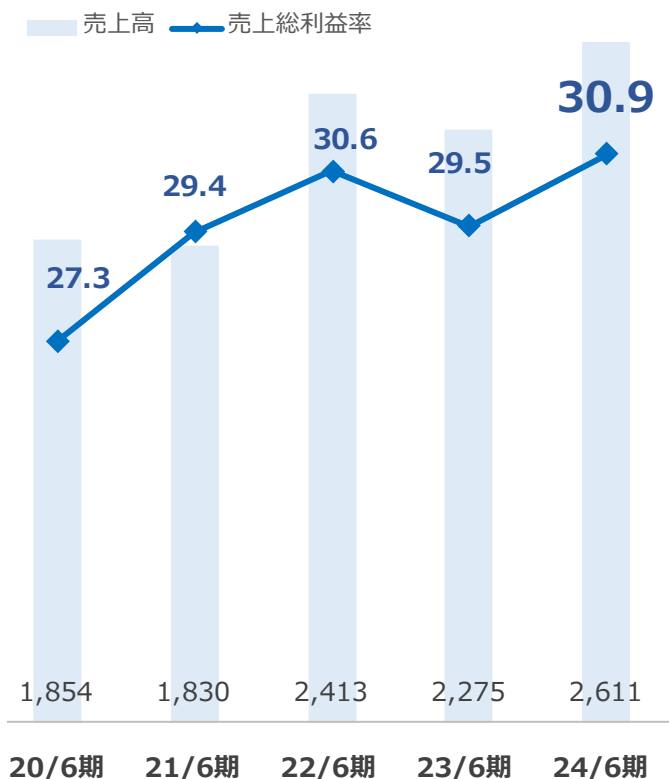
■ 半導体及び電子部品製造装置    ■ コンポーネント    ■ 材料  
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置    ■ 一般産業用装置    ■ その他



- 売上総利益率：売上高増加、ミックス改善等により30.9%と上場来最高水準
- 営業利益率：売上総利益率改善に加え、販管費率も低下し、大幅改善

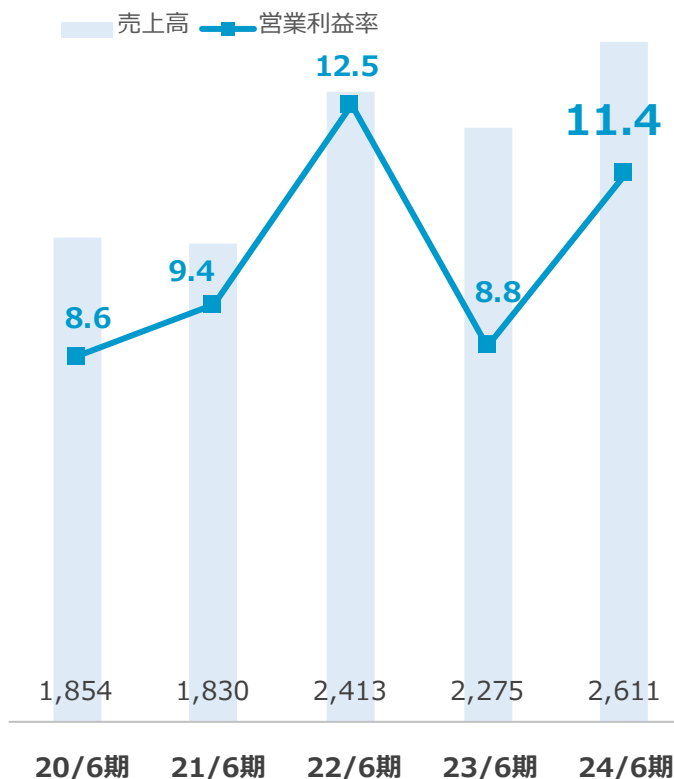
## 売上総利益率

【単位：億円、%】



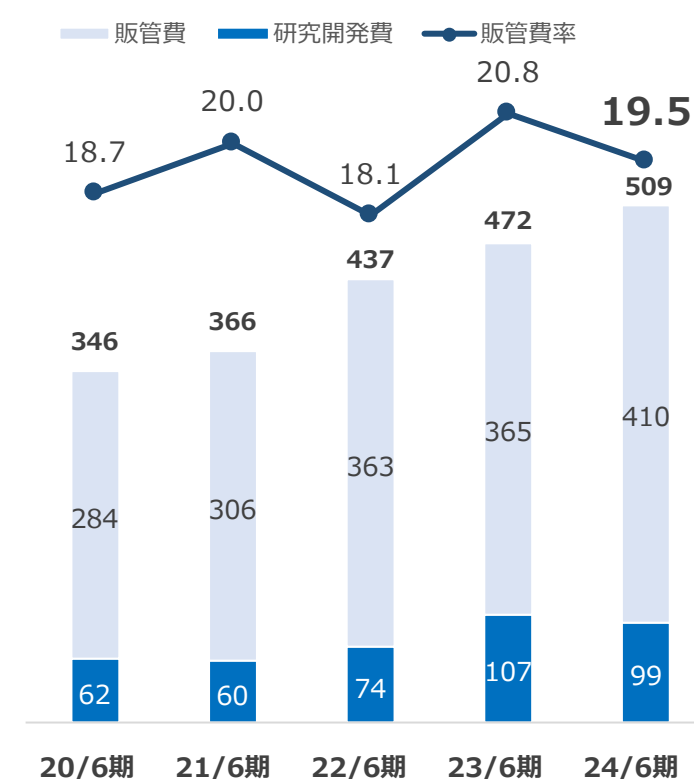
## 営業利益率

【単位：億円、%】

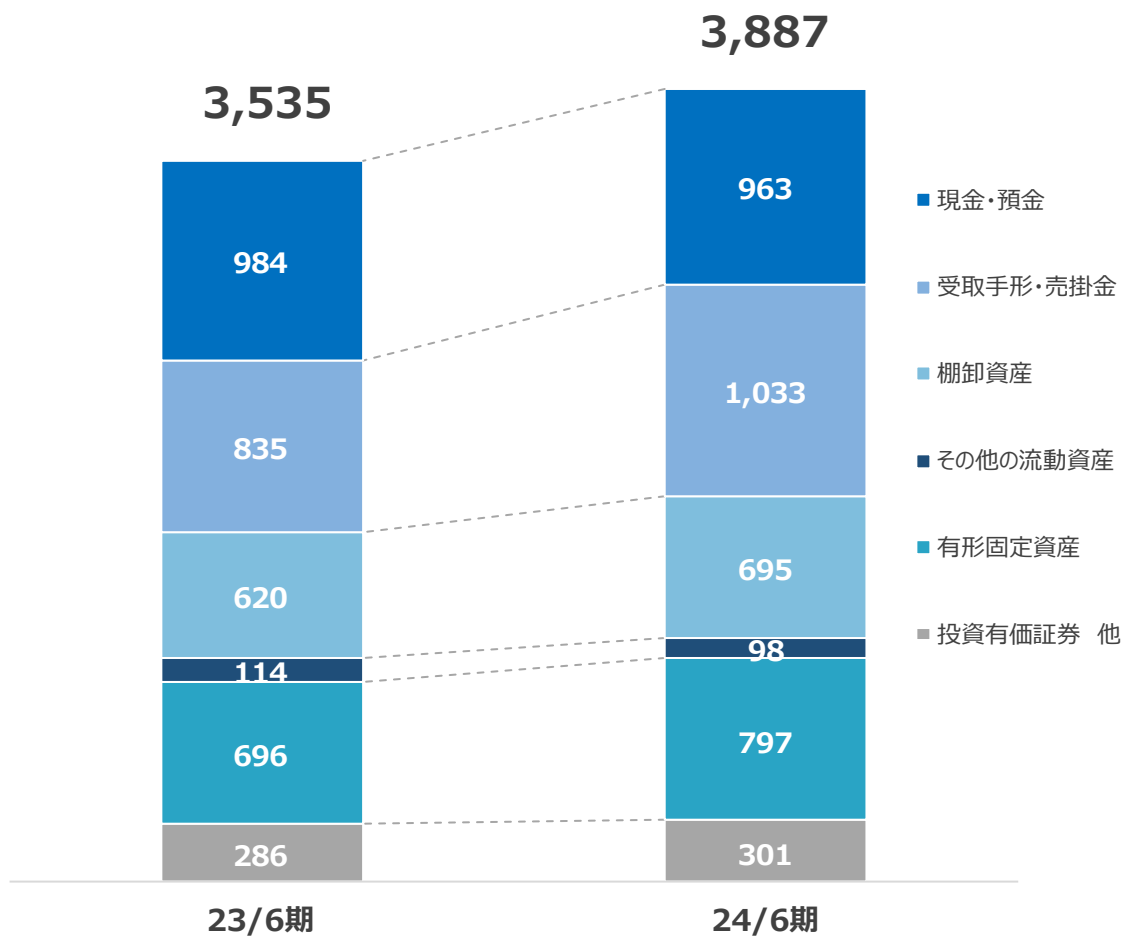


## 販管費(率)推移

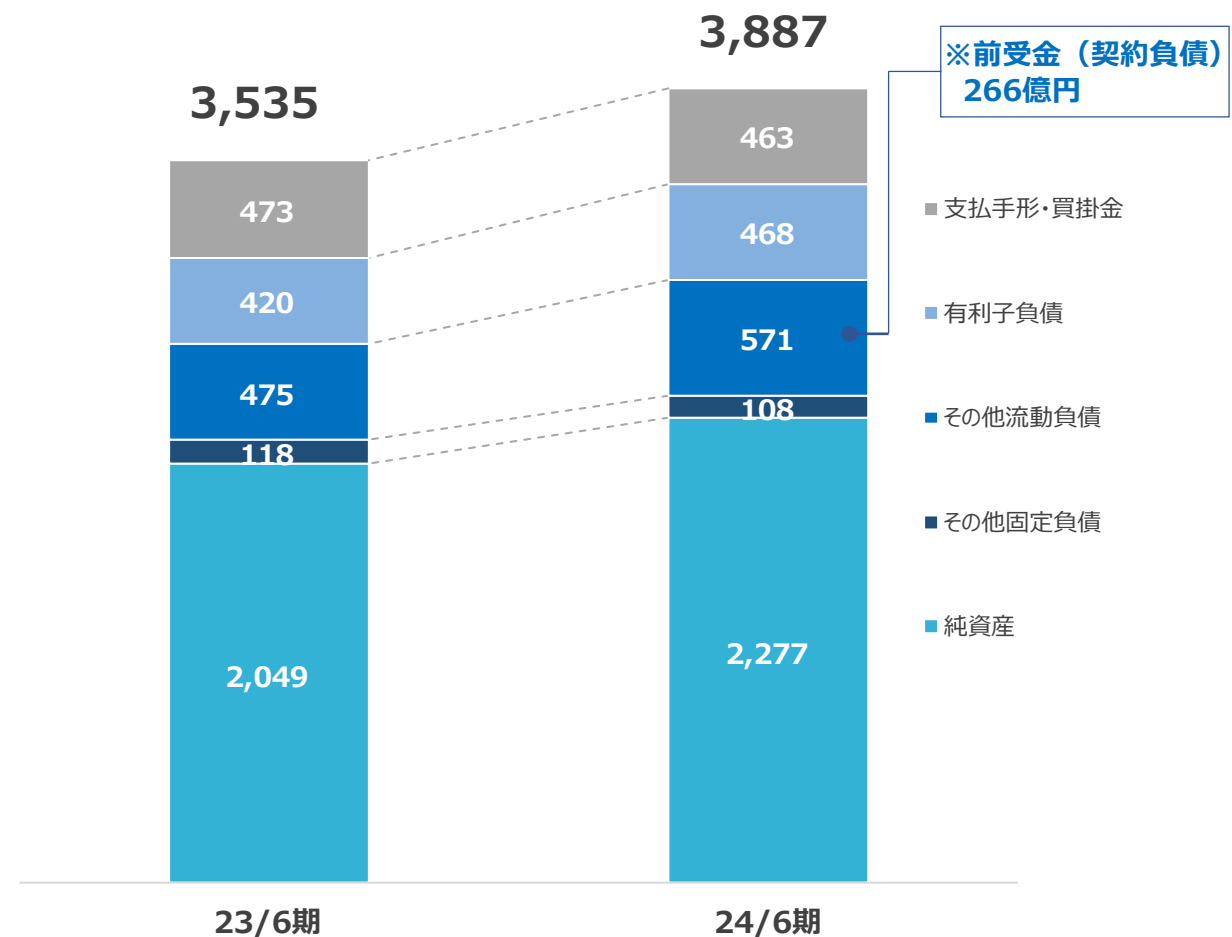
【単位：億円、%】



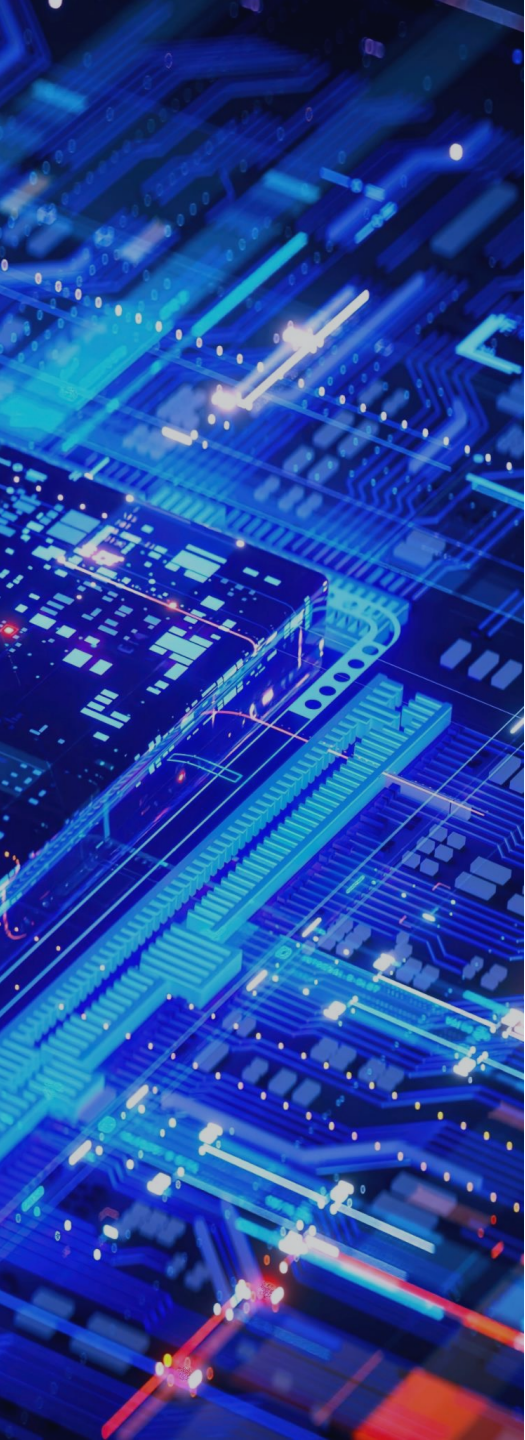
## 資産【単位：億円】



## 負債・純資産【単位：億円】







# 中期経営計画の進捗と 2025年6月期 連結業績予想

- 中期経営計画目標（26/6期）：売上高3,000億円・営業利益（率）480億円（16%）に変更なし

### 基本方針

- 真空技術による社会的価値創造
- 利益・資本効率重視の経営

### 重点戦略

1. 成長事業における製品競争力の強化
2. グローバル生産性の向上
3. 経営基盤の強化

	23/6期 実績	24/6期 実績	25/6期 計画	26/6期 目標
売上高	2,275億円	2,611億円	2,750億円	3,000億円
売上総利益率	29.5%	30.9%	32.4%	35%
営業利益（率）	199億円 (8.8%)	298億円 (11.4%)	345億円 (12.5%)	480億円 (16%)
ROE	7.3%	9.7%	10.1%	14%

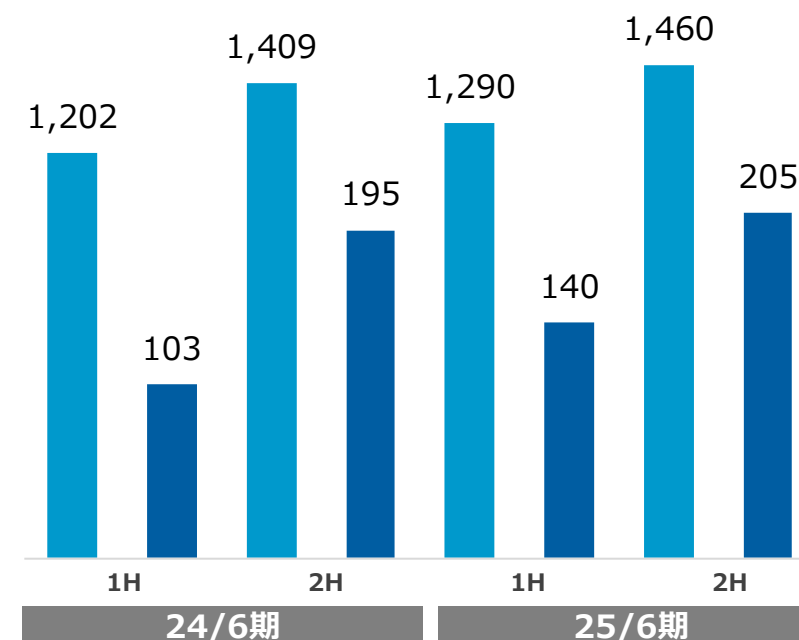
- 受注高：半導体（メモリ・ロジック）の投資回復、OLED投資本格化等により**2,700億円**（前年同期比+5%）を計画
- 売上高：受注高増加、高水準の受注残高寄与等により**2,750億円**（同+5%）を計画
- 営業利益率：**12.5%**（同+1.1pt）に改善計画
- 25/6上期・下期ともに前年同期比、増収増益を見込む

【単位：億円】	24/6期	25/6期 計画					
	実績	上期	下期	通期	前年同期比		
受注高	2,582	1,340	1,360	2,700	+118	+5%	
売上高	2,611	1,290	1,460	2,750	+139	+5%	
営業利益	298	140	205	345	+47	+16%	
率	11.4%	10.9%	14.0%	12.5%	+1.1pt	-	
経常利益	298	140	210	350	+52	+18%	
率	11.4%	10.9%	14.4%	12.7%	+1.3pt	-	
親会社株主に帰属する 当期純利益	202	90	140	230	+28	+14%	
率	7.7%	7.0%	9.6%	8.4%	+0.6pt	-	

## 売上高と営業利益の推移

【単位：億円】

■ 売上高 ■ 営業利益

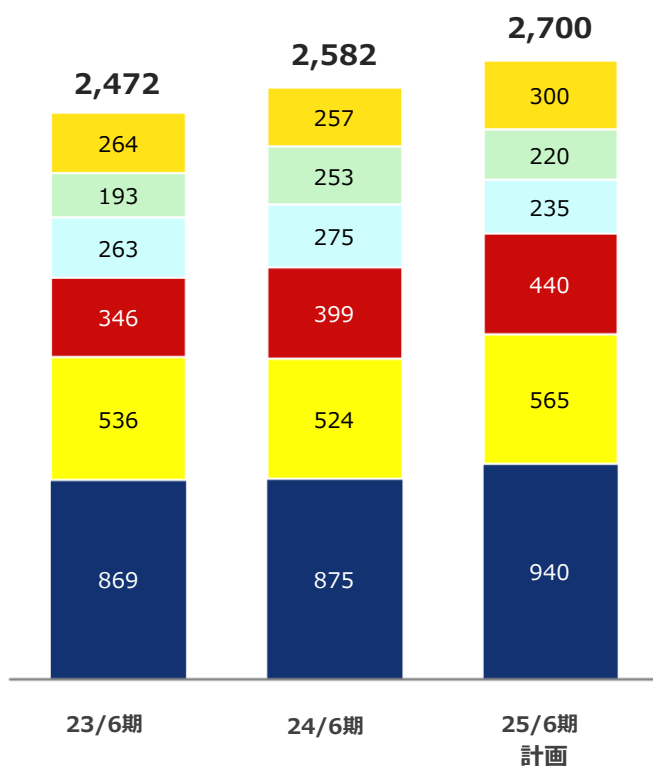


- 受注高：半導体（メモリ・ロジック）の投資回復、OLED投資本格化、コンポーネント（リークテスト装置等）、その他（表面分析装置等）増加で2,700億円を計画
- 売上高：受注高増加、高水準の受注残高寄与等で2,750億円を計画

## 受注高

【単位：億円】

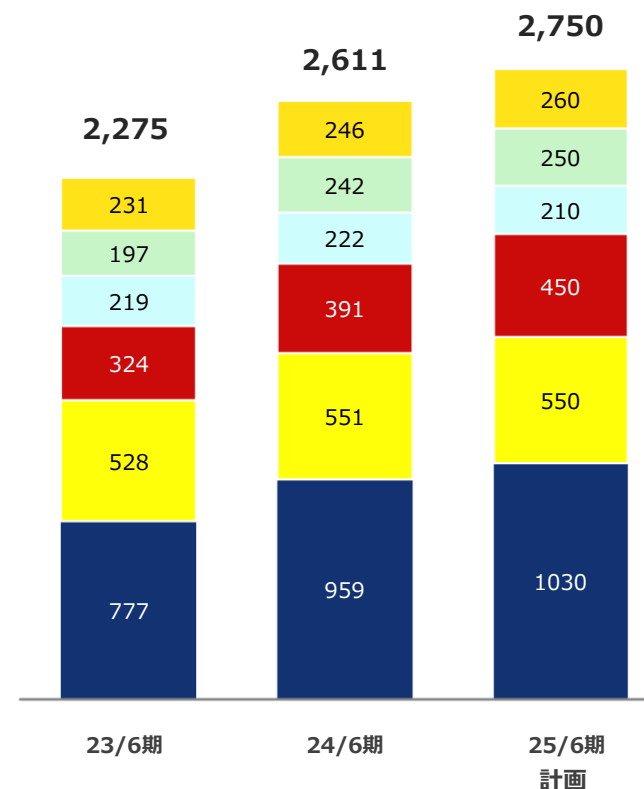
■ 半導体及び電子部品製造装置    ■ コンポーネント    ■ 材料  
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置    ■ 一般産業用装置    ■ その他



## 売上高

【単位：億円】

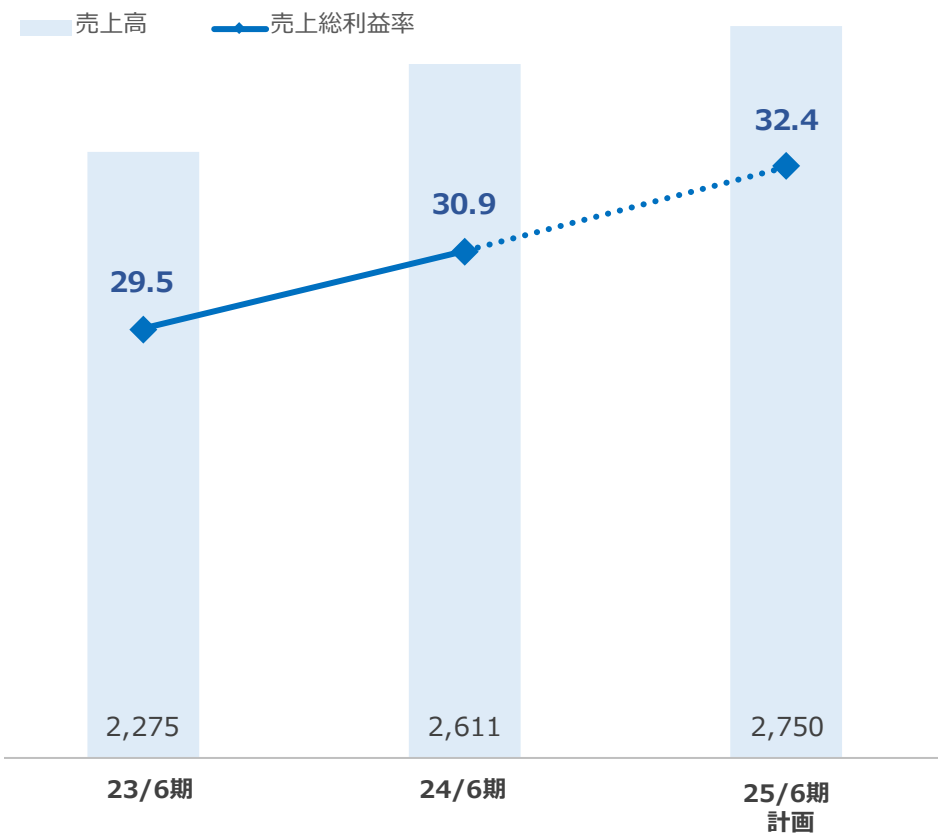
■ 半導体及び電子部品製造装置    ■ コンポーネント    ■ 材料  
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置    ■ 一般産業用装置    ■ その他



- 売上総利益率は売上高増加、半導体電子比率アップによるミックス効果等で着実に改善
- 営業利益率も改善計画

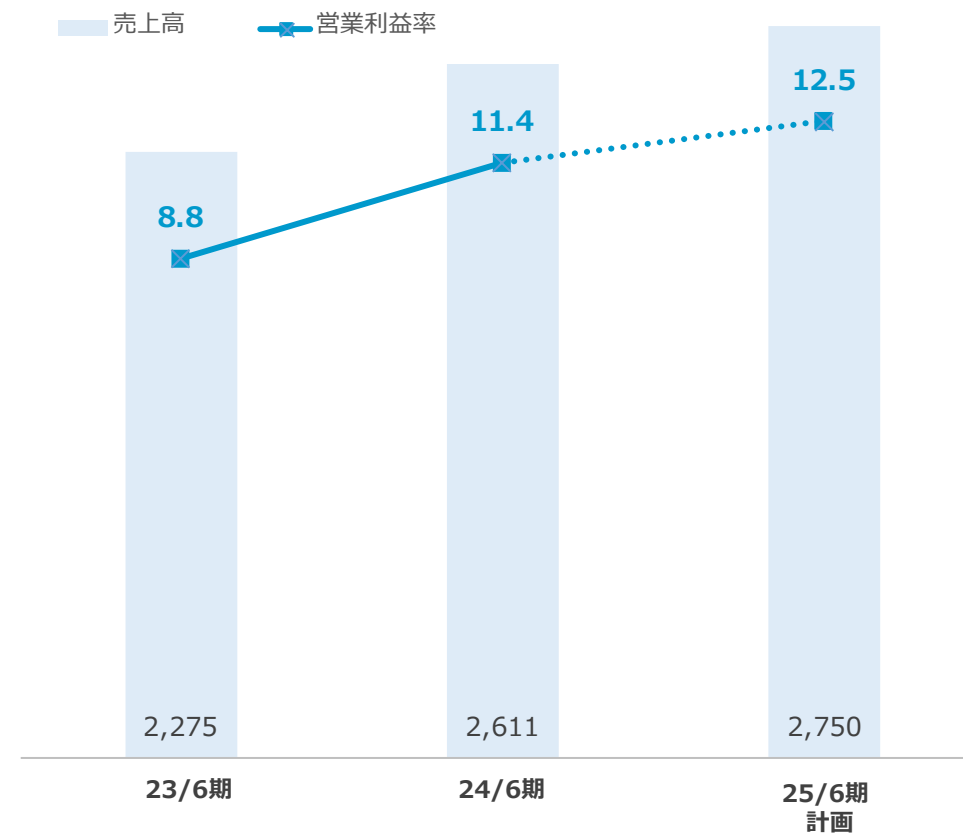
## 売上総利益率

【単位：億円、%】



## 営業利益率

【単位：億円、%】

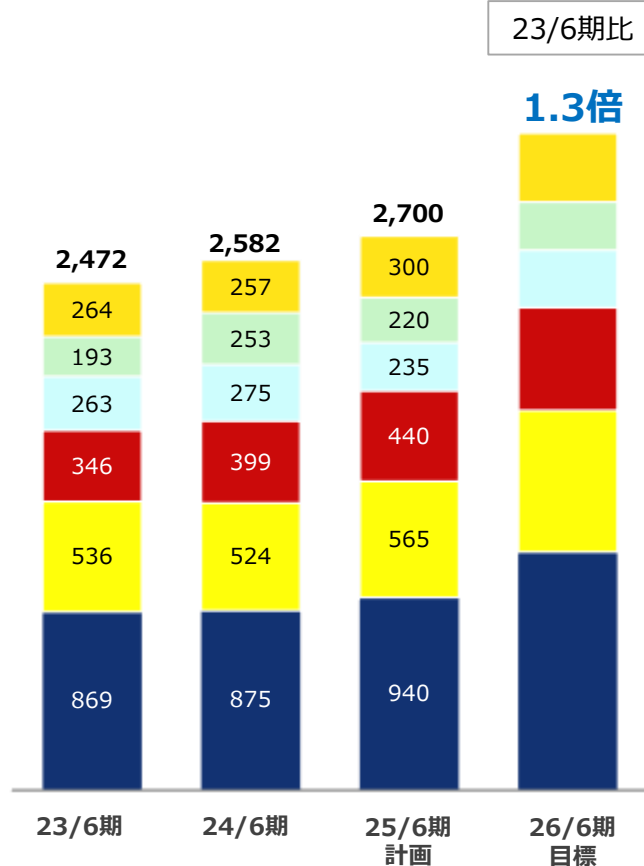


- 半導体（メモリ・ロジック）の投資回復・新工程参入、バッテリー関連等に加え、ITパネル用OLEDやリークテスト装置（コンポーネント）、表面分析装置（その他）が成長を牽引
- 25/6期から26/6期にかけて成長を加速

## 受注計画

【単位：億円】

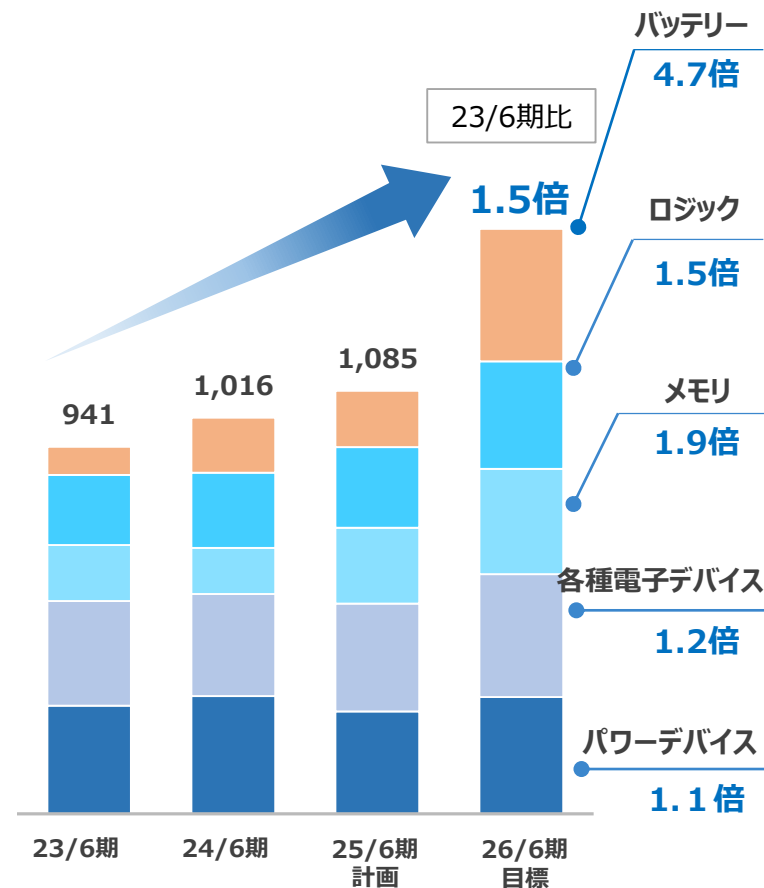
■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料  
 ■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



## 成長ドライバーの受注計画

【単位：億円】

■ パワーデバイス ■ 各種電子デバイス ■ メモリ ■ ロジック ■ バッテリー



> 車載用EVバッテリー本格採用は、26/6期の見込み⇒投資本格化とともに拡大

> MHM工程での新規顧客採用  
 > ロジック投資回復に加え、新工程参入で成長  
 > レガシー半導体投資継続

> DRAM・NAND等メモリ投資回復に加え、新工程参入で成長

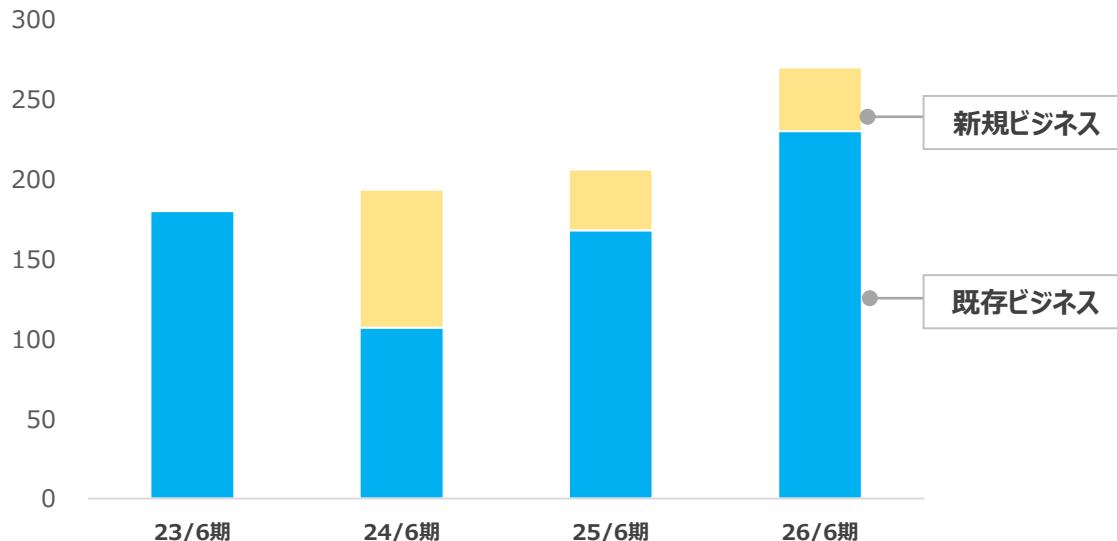
> パッケージング（WLP+PLP）、センサー・MEMS、μOLED等、技術革新投資・増産投資が継続

> EV成長鈍化により、27/6期以降に投資本格化⇒SiC：ウェハーサイズアップ・構造変化を機に拡販を目指す

- メモリ（DRAM・NAND）、ロジックの投資回復・新規顧客開拓・新工程参入で着実に成長

### ロジック受注計画

【単位：億円】

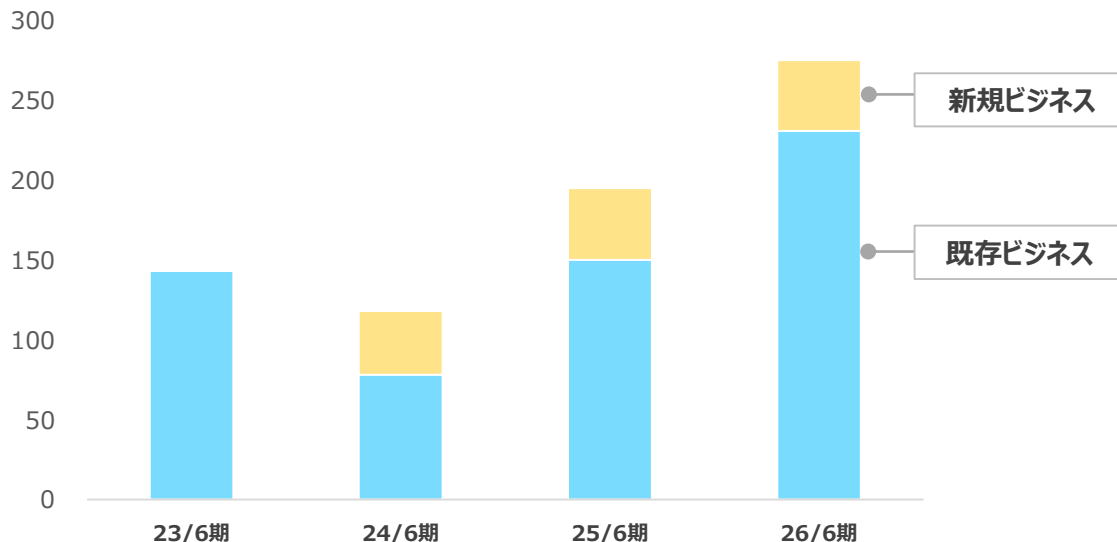


- > 新規ビジネス：
  - ① MHM工程の新規顧客採用
  - ② トランジスタ周辺工程（FEOL）採用
  - ③ 配線周りの工程の拡大（セカンドベンダー期待）

- > 既存ビジネス：24/6期投資減速⇒25/6期より投資回復、レガシービジネス⇒生産増強投資継続

### メモリ受注計画

【単位：億円】



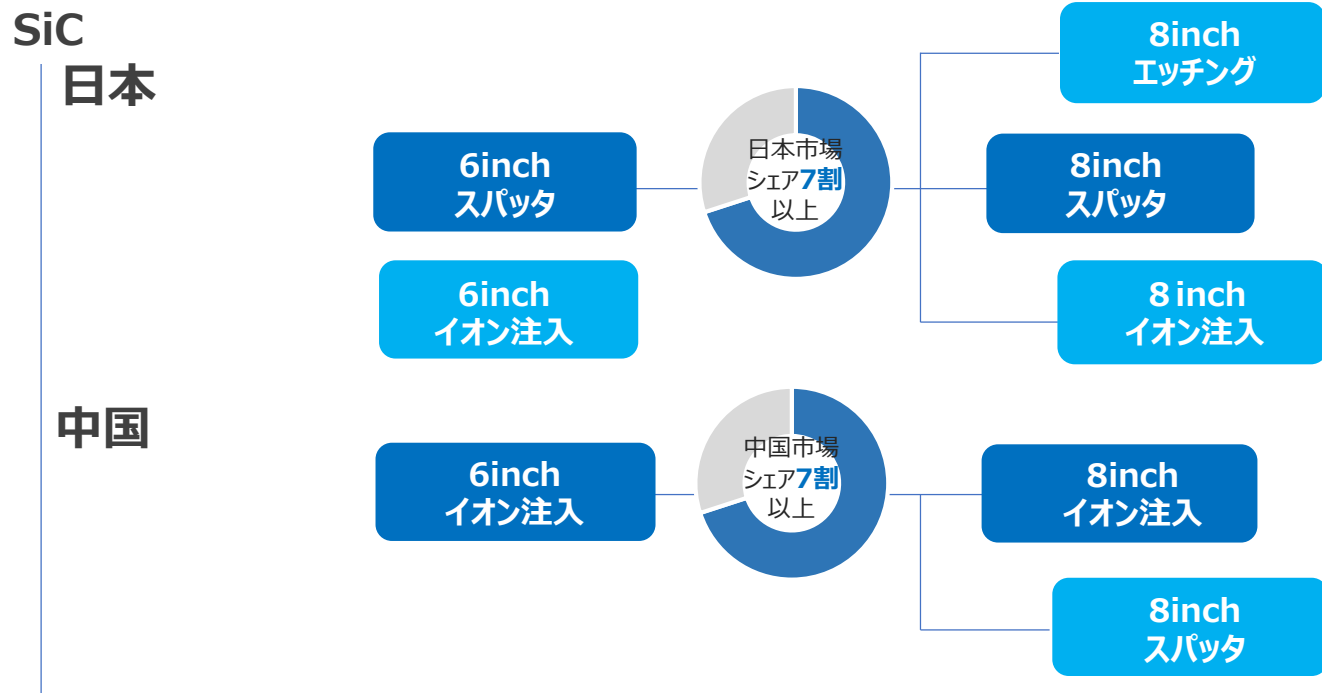
- > 新規ビジネス：
  - ① DRAM・HBM工程等採用
  - ② 配線周りの工程の拡大（セカンドベンダー期待）

- > 既存ビジネス：DRAM・NANDともに25/6期から投資回復

- EV成長鈍化により、SiC・8inchの本格投資は27/6期以降を見込む
- ①高いシェアを有している日本：スパッタ装置、中国：イオン注入装置に加え、②日本：イオン注入装置・エッチング装置、中国：スパッタ装置のクロスセルによる拡販を目指す

～24/6期

25/6期～



> SiC : プレーナ→トレンチ構造切替を機に電子部品で実績豊富なエッチング装置を展開



エッチング装置

> SiC : ウェハーサイズアップ<sup>o</sup> (6→8inch) を機に日本・中国でスパッタ装置・イオン注入装置をクロスセルで拡販



イオン注入装置



スパッタリング装置

Si-MOSFET  
中国



> Si-MOSFET : カスタマイズ対応、価格競争力 (中国現地生産) で蒸着装置拡販



蒸着装置



- 今期は前期並みの投資を見込むが、26/6期は車載用EVバッテリー採用とともに投資本格化
- ①フィルム幅広化（アルミ）による生産性向上、②負極集電体（銅）への対応、③次世代電池負極（リチウム）の開発で成長

## EVバッテリー部材用両面蒸着巻取装置

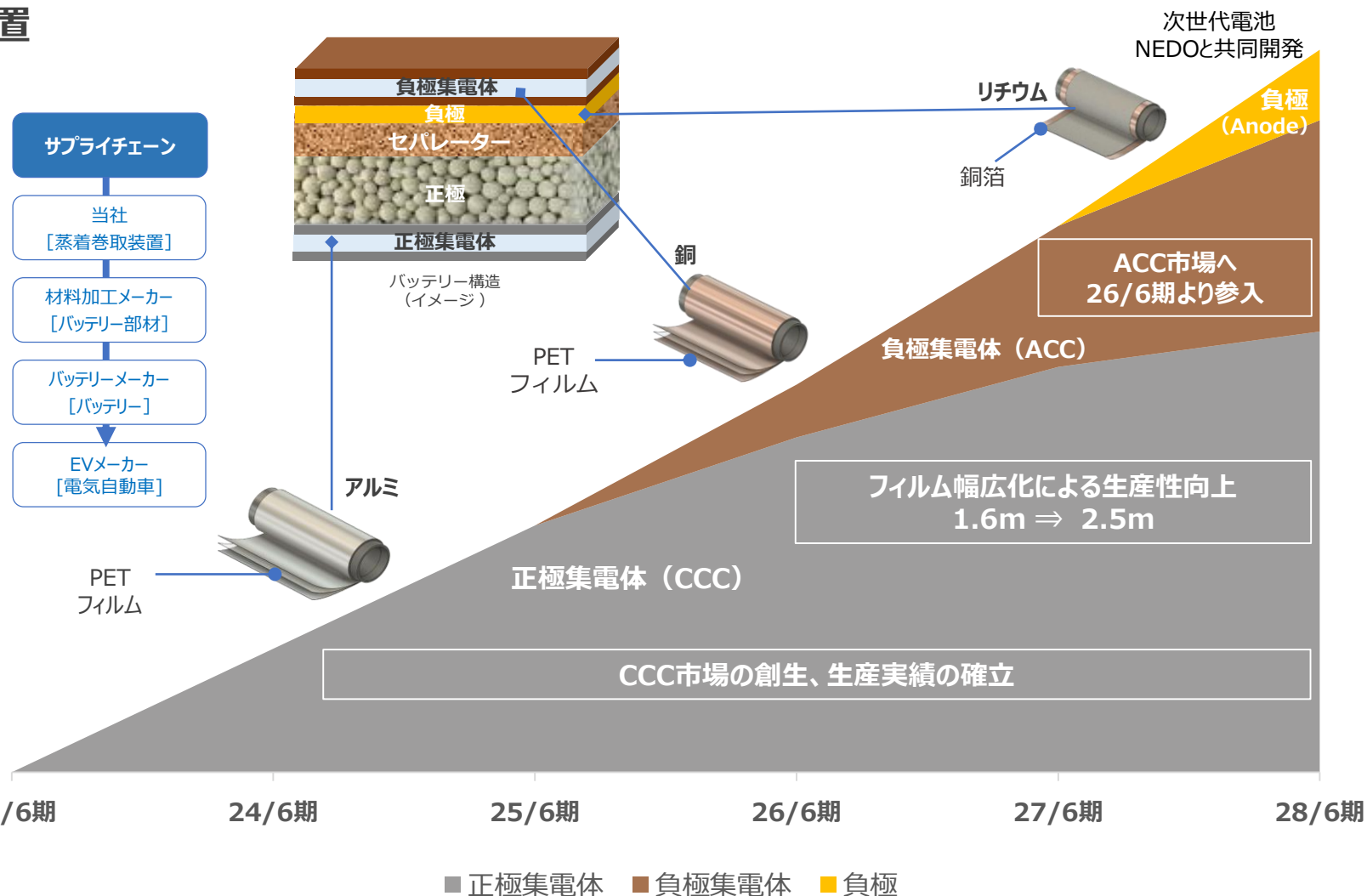
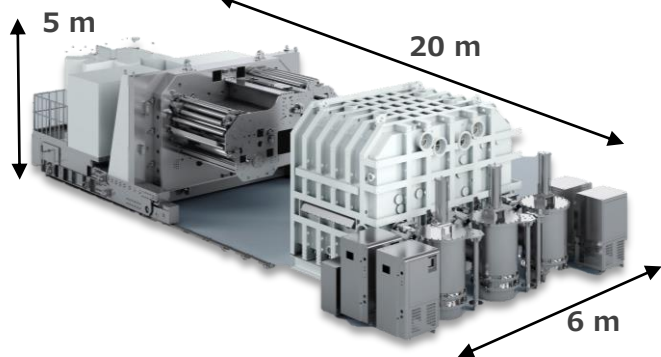
### 両面蒸着膜集電体の効果

- ① 安全性向上
- ② 小型軽量化
- ③ 部材コスト低減
- ④ GHG低減

### 強み

- 車載用フィルムキャパシタ向け蒸着巻取装置で培った技術力と信頼性
- 両面一括・厚膜成膜による**高い生産性**
- 熱ダメージ抑制による高速長尺成膜

### 両面蒸着巻取装置



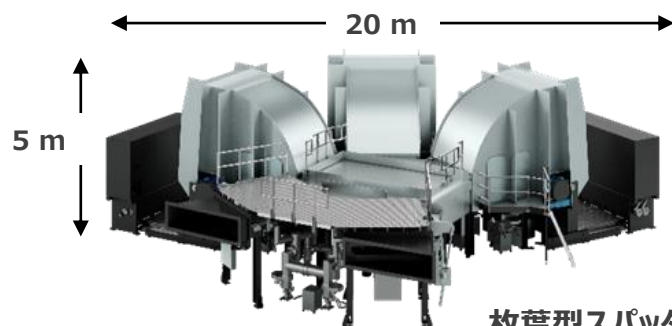
- ITパネル（タブレット・PC）用OLED（G8.7クラス）の量産投資本格化  
⇒G8.7スパッタリング装置・クライオポンプでビジネスチャンス

## ITパネル用OLED（G8.7）スパッタリング装置

大型化・低パーティクル化・低温成膜を実現する  
枚葉型スパッタリング装置

### 強み

- ① **枚葉型での大型化（G8.7）・低パーティクル化**  
スマホ用（G6）と同等の回路配線幅での低パーティクル実現  
大型化による生産性と低パーティクルを両立
- ② **タッチセンサーの高速成膜**  
温度に敏感なOLEDプロセスでの低温成膜  
⇒高速成膜による高い生産性実現



枚葉型スパッタリング装置（G8.7）

## クライオポンプ<sup>°</sup>「コンポーネント」品目に分類

## OLED蒸着装置向けクライオポンプのデファクトスタンダード

### 強み

- ① **振動が少ない**：蒸着マスクのアライメント（位置決め）への影響を最小限化
- ② 高性能な排気性能
- ③ 省エネ

### 大口徑クライオポンプ（22型）



2023年度 日本真空工業会（JVIA）  
「真空コンポーネント・部品・材料部門賞」受賞

OLED蒸着装置大型化に伴い  
排気性能向上と省エネ実現（従来比30%減）

- EV化に伴うリークテスト需要等の高まり、表面分析ニーズの拡大等でビジネス機会が増大

### リークテスト装置 「コンポーネント」品目に分類

製品・部品の気密性検査の用途拡大

#### 強み

- ① 従来の自動車部品・家電製品に加えて、EV用バッテリー等  
**幅広い用途にカスタマイズ**
- ② 業界トップクラスの性能
- ③ 中国現地生産・販売による充実したアフターサポート

EVバッテリー用  
リークテスト装置



空調・熱交換器用  
リークテスト装置



### 表面分析装置 「その他」品目に分類

ラボ型の表面分析装置で世界の過半のシェア

#### 強み

- ① **幅広い表面分析手法技術**
- ② 自動化・操作の簡便化による高い生産性
- ③ 高精度データ取得・活用

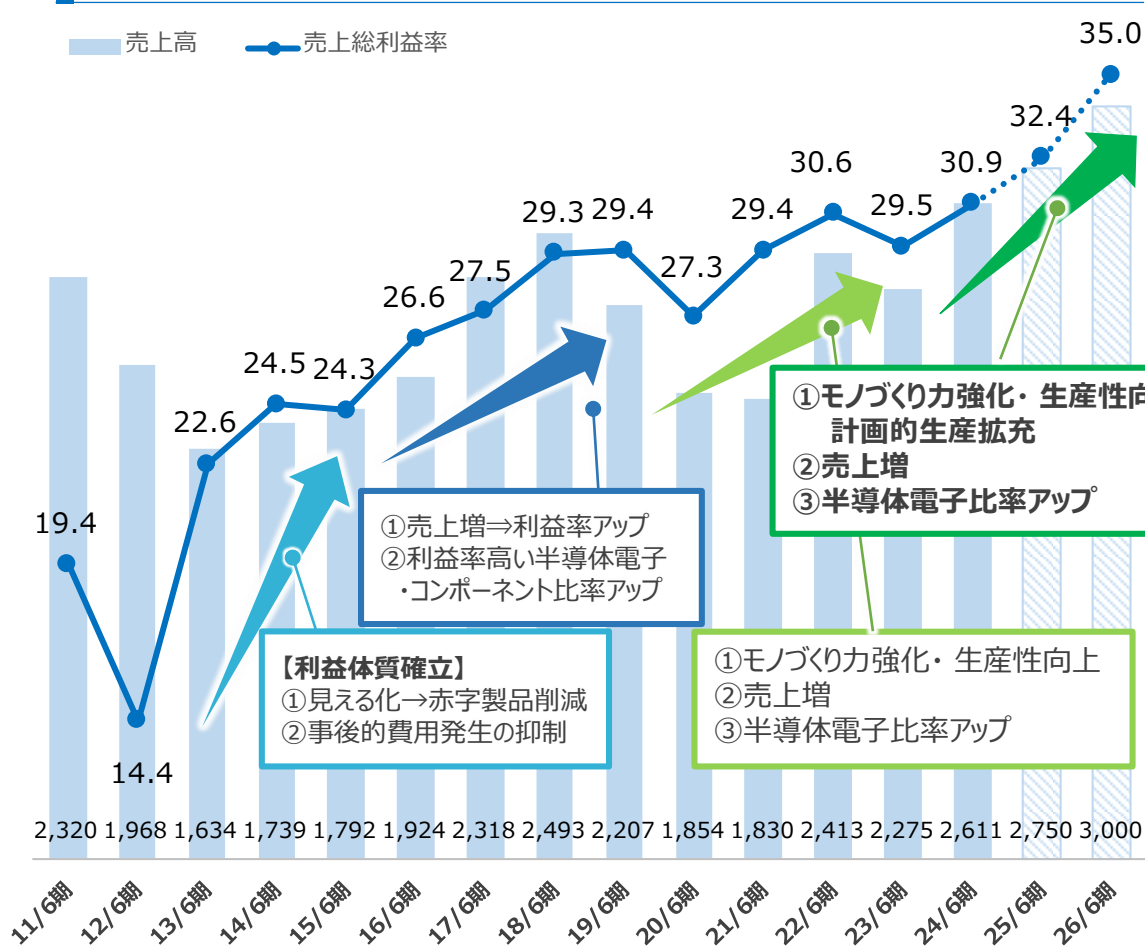
X線光電子分光分析装置



同業他社の 表面分析手法		アルバック・ ファイ	A社	B社	C社	D社	E社	
分析 手法	XPS (X線光電子分光法)	●	●	●	●			
	AES (オージェ電子分光法)	●			●			
	SIMS (二次イオン 質量分析法)	TOF-SIMS (最表面分析)	●				●	
		D-SIMS (深さ方向分析)	●					●

- 半導体・パワーデバイス・バッテリー等で計画的生産体制を拡充
- 計画的生産拡充、製品企画力強化、生産性向上、戦略購買力強化を進め、利益率改善
- 売上高増加、半導体電子比率アップによるミックス改善等により、26/6期に売上総利益率35%を目指す

## 売上総利益率推移【単位：%】



### 製品企画力強化

開発・営業・技術・設計・購買・製造・サービスの連携強化  
QCDを意識した製品企画徹底

### 戦略購買力強化

計画的生産に対応した戦略購買体制構築  
キーサプライヤーとの連携強化

### モノづくり力強化

### 生産性向上

最適拠点生産  
柔軟な経営資源配分体制構築

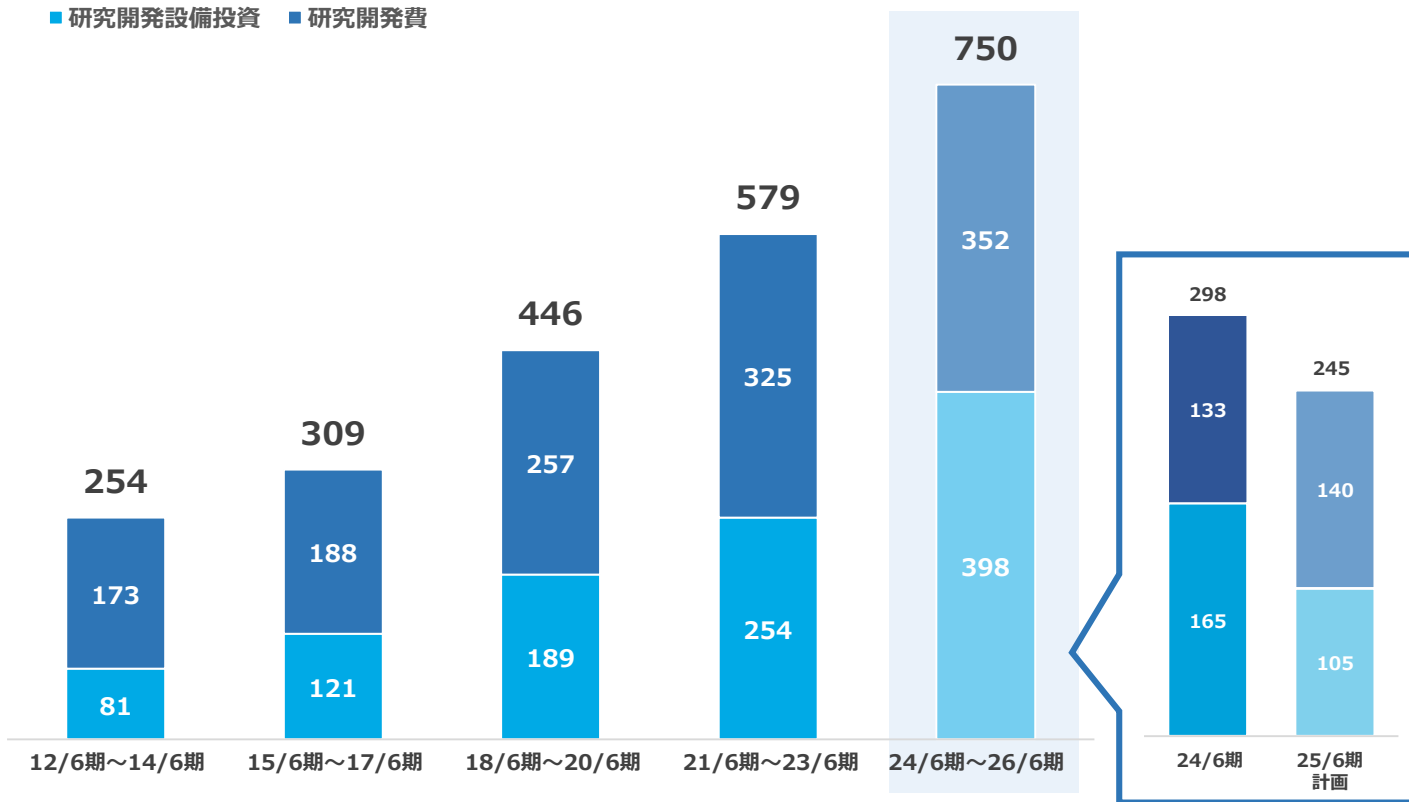
### 計画的生産拡充

モジュール化・標準化  
リードタイム短縮

### 情報システム基盤強化

- 成長ドライバー(半導体、パワーデバイス、バッテリー等)の研究開発強化
  - 研究開発投資計画（研究開発設備投資＋研究開発費、24/6～26/6期）750億円に変更なし
  - 韓国テクノロジーセンター竣工：デバイス検証・量産技術の共同開発・検証を加速し、半導体ビジネスの成長を牽引
- ⇒ 中長期的な成長に向けた研究開発投資継続

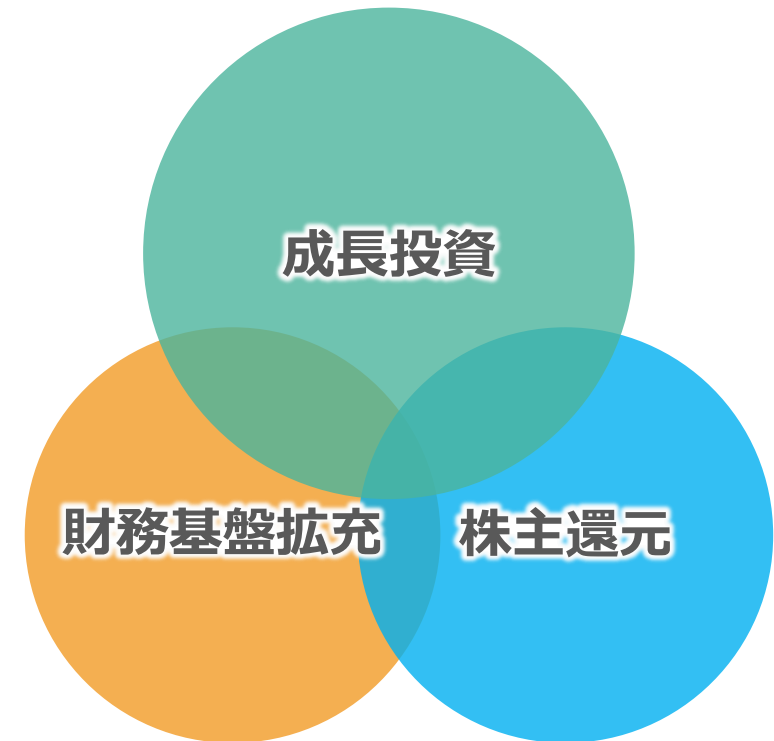
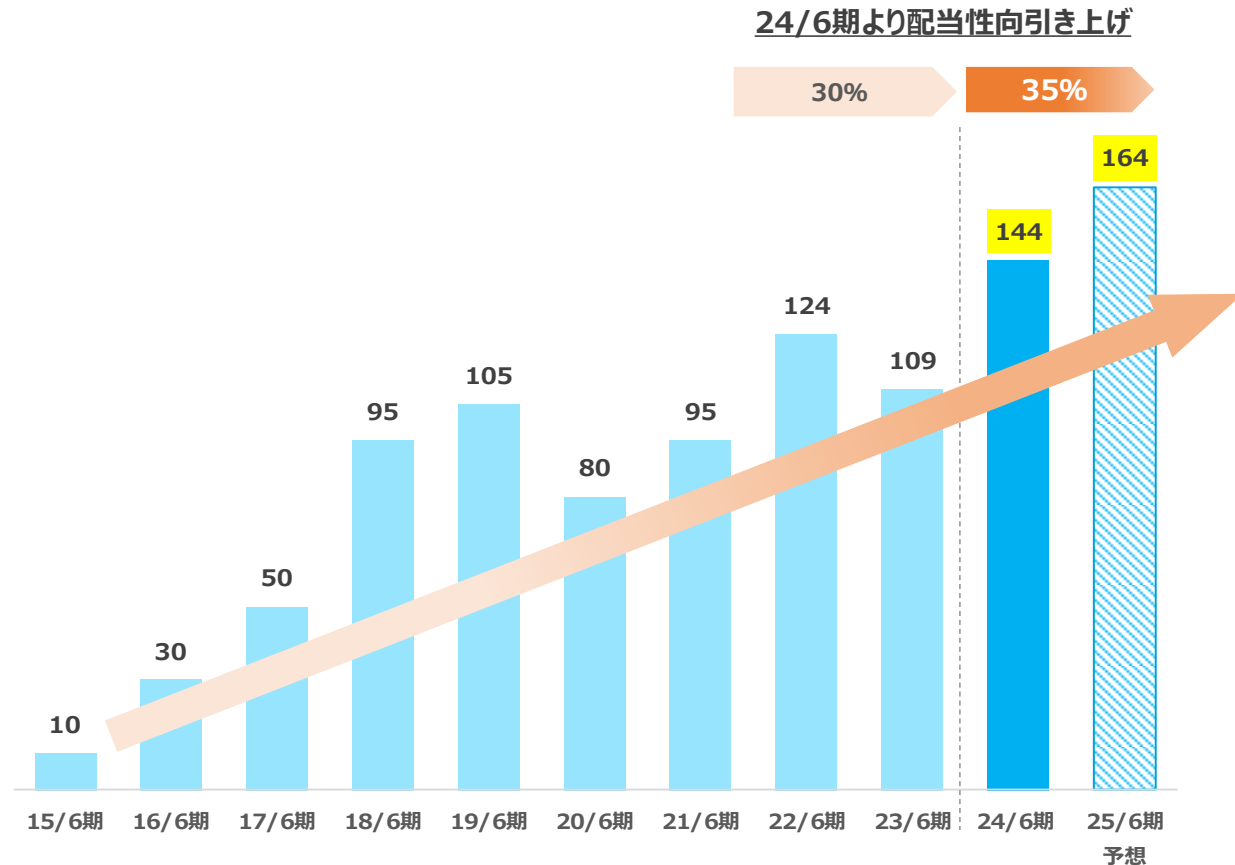
### 研究開発投資推移（3年合計）【単位：億円】

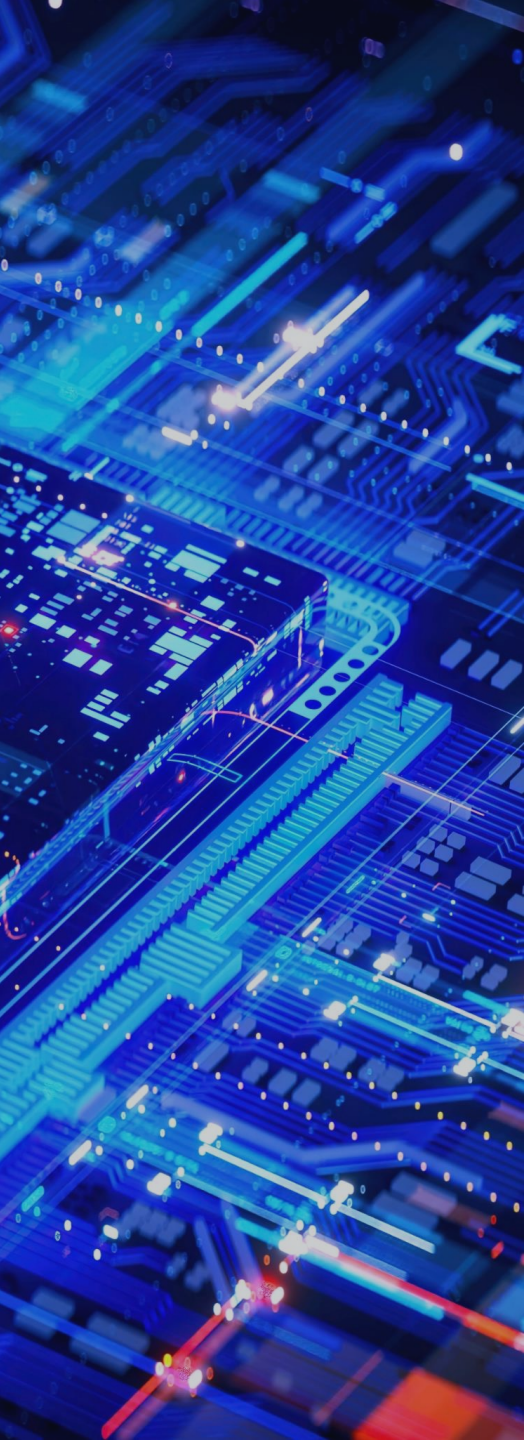


- > 半導体：4割強  
ロジック・メモリ (MHM・配線工程向けスパッタ)
- > 電子：2割強  
パワーデバイス (イオン注入・スパッタ・エッチング等)
- > ディ스플레이・エネルギー：1割半ば  
バッテリー (蒸着)
- > その他：2割強

- 半導体、電子を中心に成長分野への開発投資を強化
- 株主還元を最重要政策の一つと位置づけ、更なる成長により長期的な配当増額を目指す
- 24年6月期より業績連動配当性向を35%へ引き上げ、株主還元を拡充  
⇒24/6期配当金144円（前回予想比+30円）は過去最高
- 業界変動や技術革新の激しい業界にあり、これらのリスクや資金需要に対応するため財務基盤も拡充

### 1株当たり配当金推移 【単位：円】





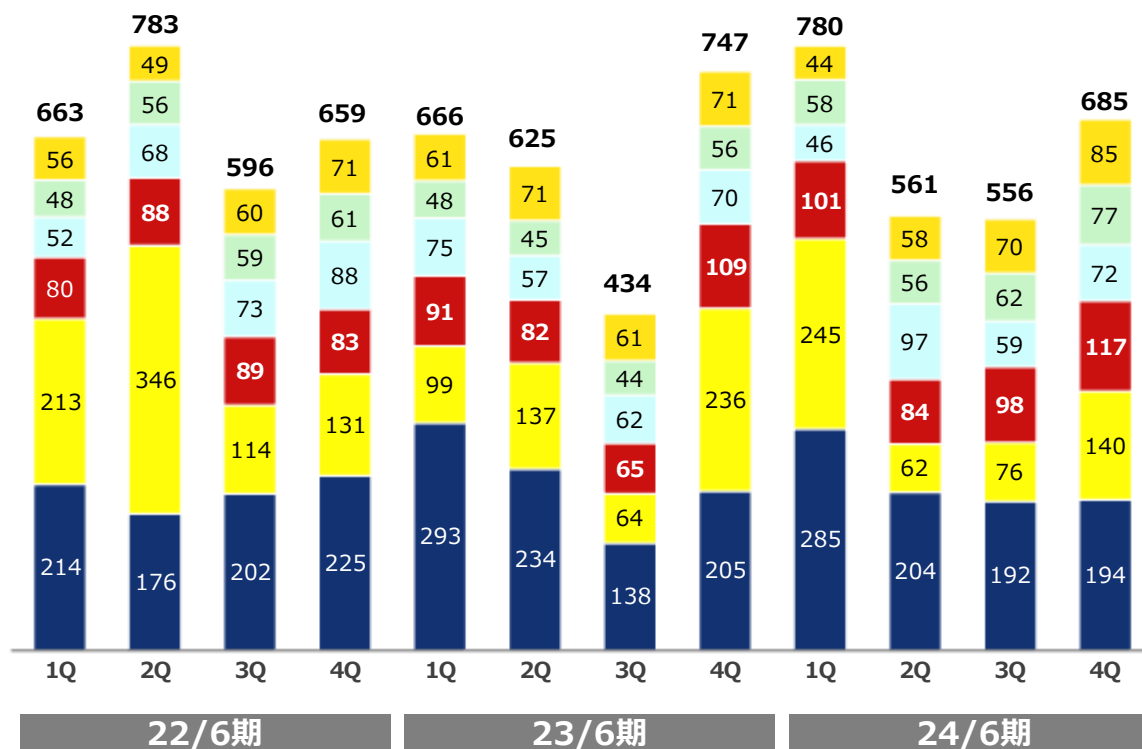
# 補足資料

【単位：億円】	23/6期				24/6期				前年同期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	増減額	増減率
	受注高	666	625	434	747	780	561	556	685	-62
売上高	562	552	496	666	550	652	650	759	+93	+14%
売上総利益	165	168	147	191	153	201	220	233	+42	+22%
率	29.3%	30.5%	29.7%	28.7%	27.7%	30.8%	33.8%	30.7%	+2.0pt	-
販管費	113	115	125	119	124	126	119	139	+20	+17%
営業利益	51	53	23	72	28	75	101	94	+22	+30%
率	9.1%	9.7%	4.6%	10.8%	5.1%	11.5%	15.5%	12.3%	+1.5pt	-
経常利益	52	65	39	72	29	81	95	93	+21	+29%
率	9.3%	11.8%	7.8%	10.8%	5.3%	12.4%	14.6%	12.3%	+1.4pt	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	41	53	24	24	11	57	64	69	+45	+188%
率	7.2%	9.6%	4.9%	3.6%	2.1%	8.8%	9.9%	9.1%	+5.5pt	-



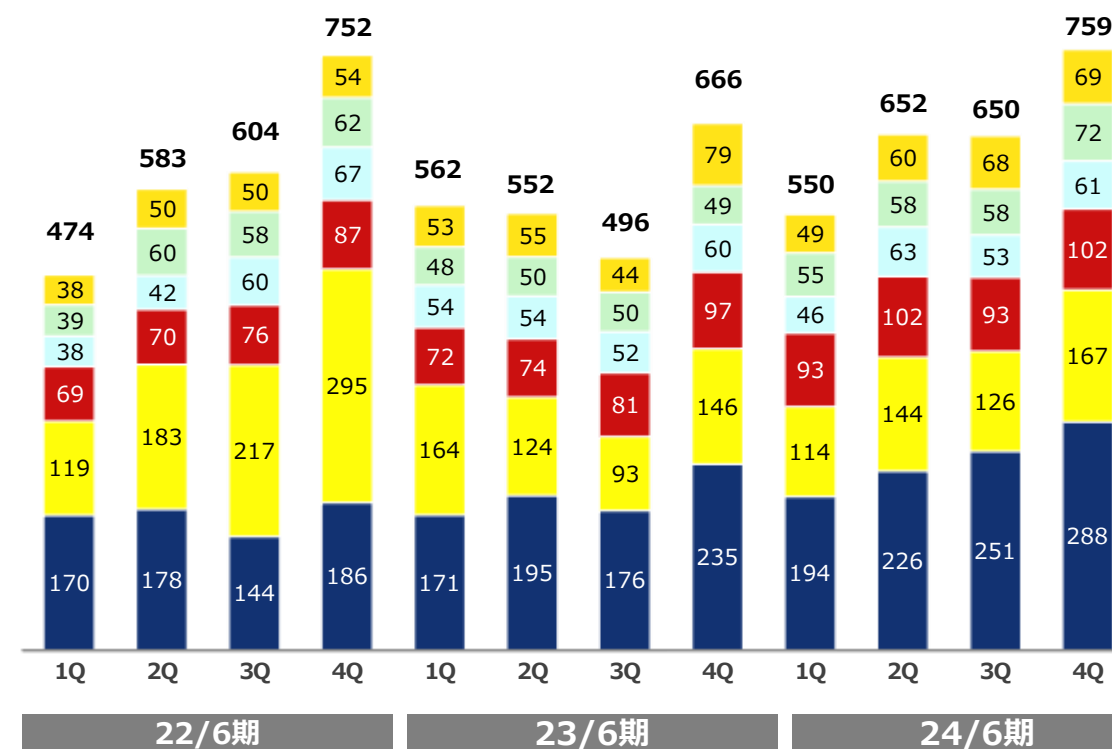
## 受注高

【単位：億円】



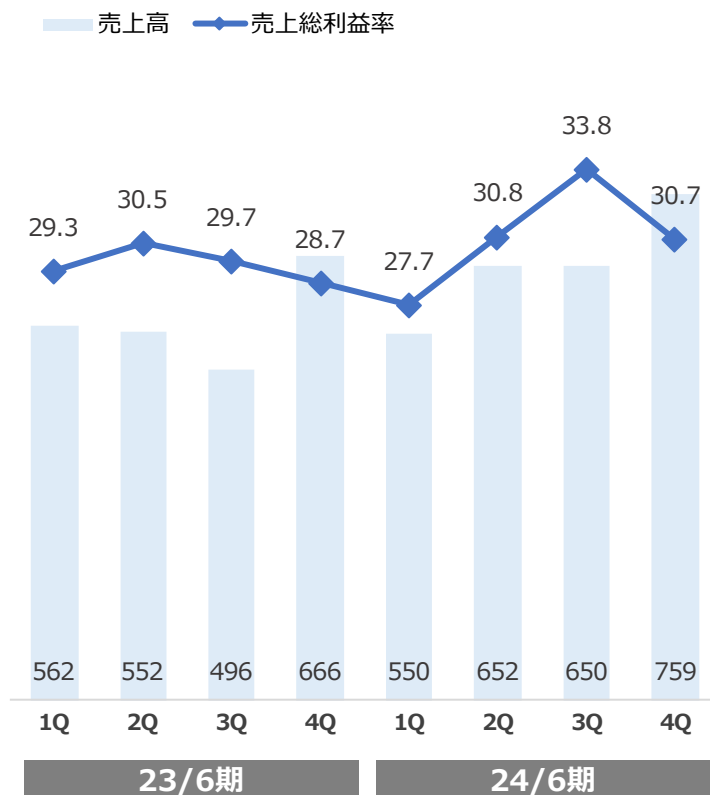
## 売上高

【単位：億円】



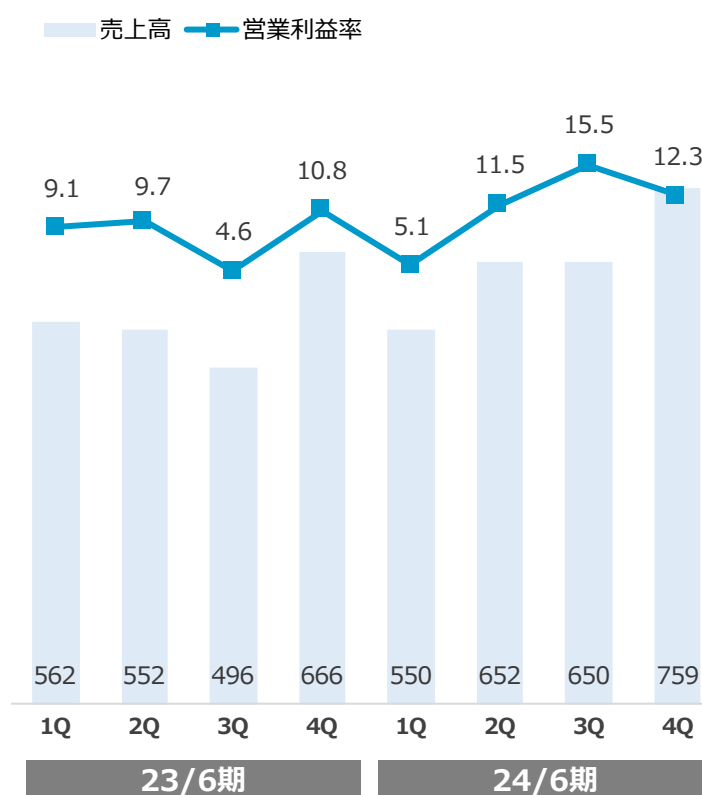
## 売上総利益率

【単位：億円、%】



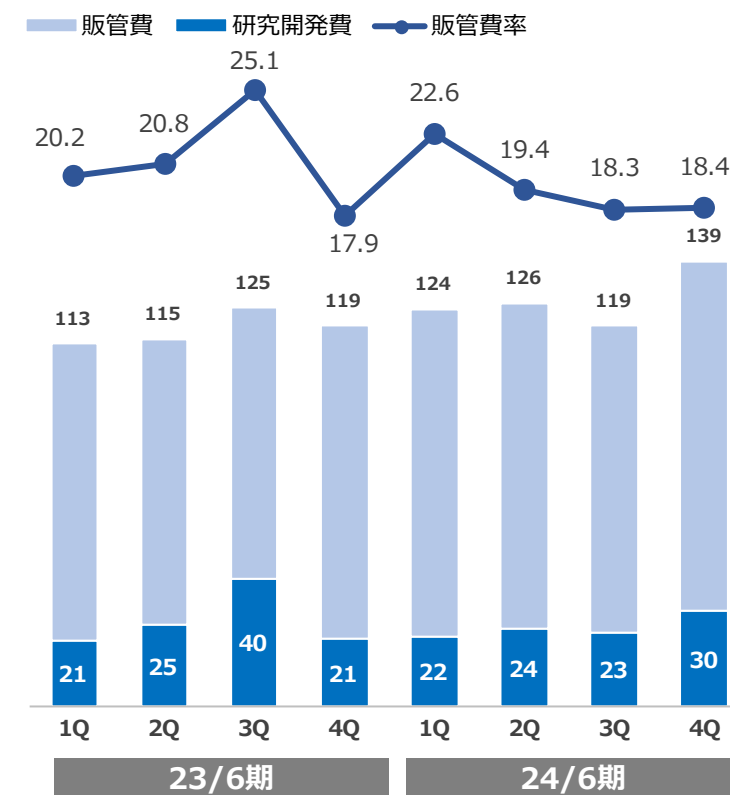
## 営業利益率

【単位：億円、%】



## 販管費(率)推移

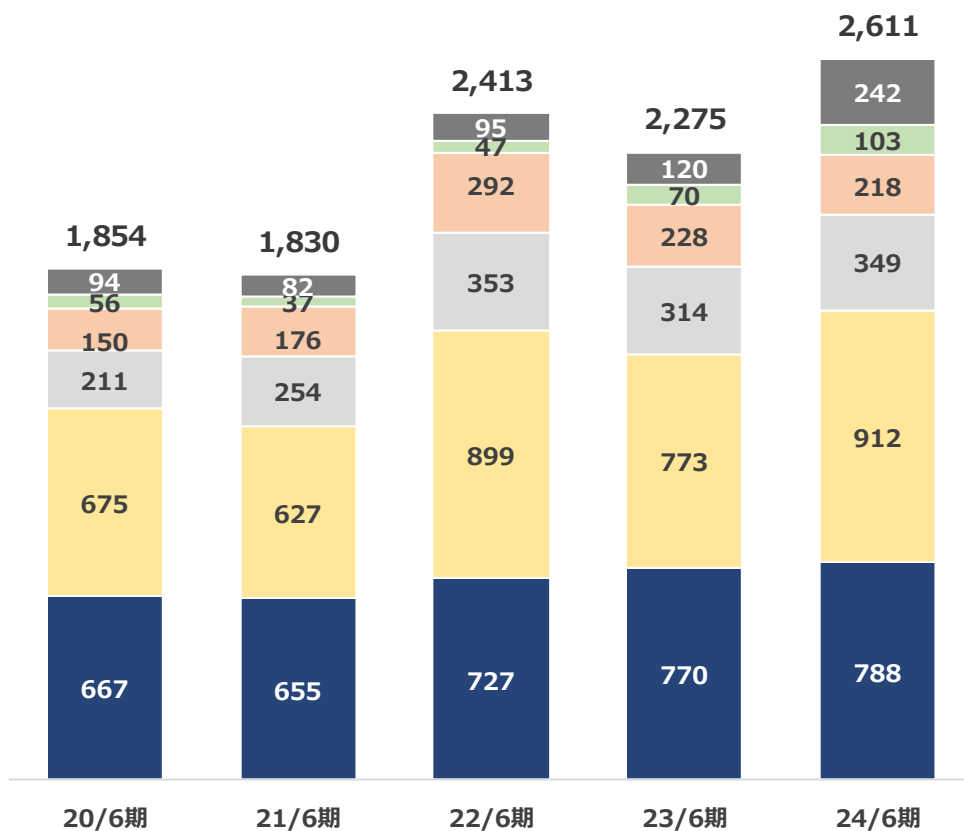
【単位：億円、%】



## 売上高

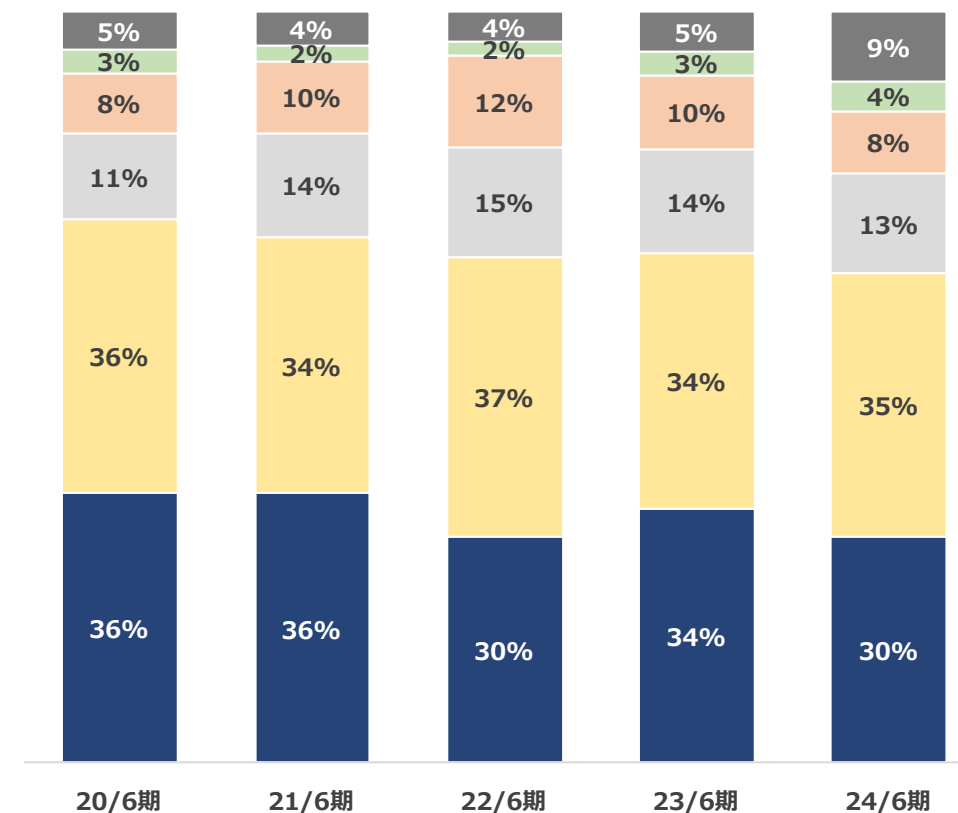
【単位：億円】

■ 日本 ■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾 ■ その他アジア ■ 欧米他



## 売上高比率

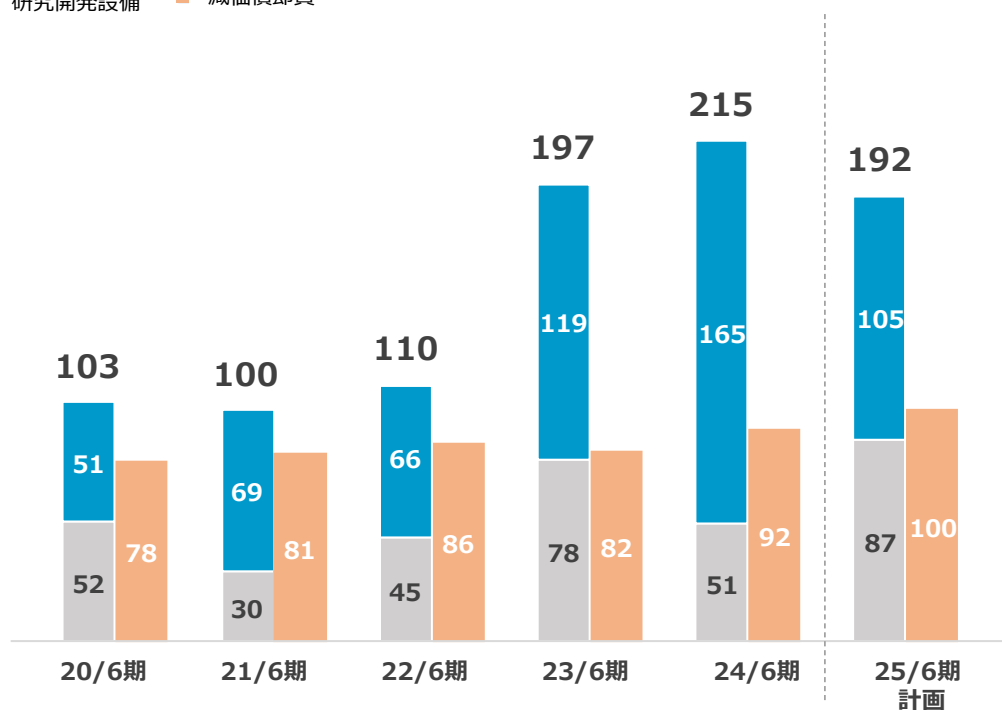
■ 日本 ■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾 ■ その他アジア ■ 欧米他



## 設備投資の推移・計画

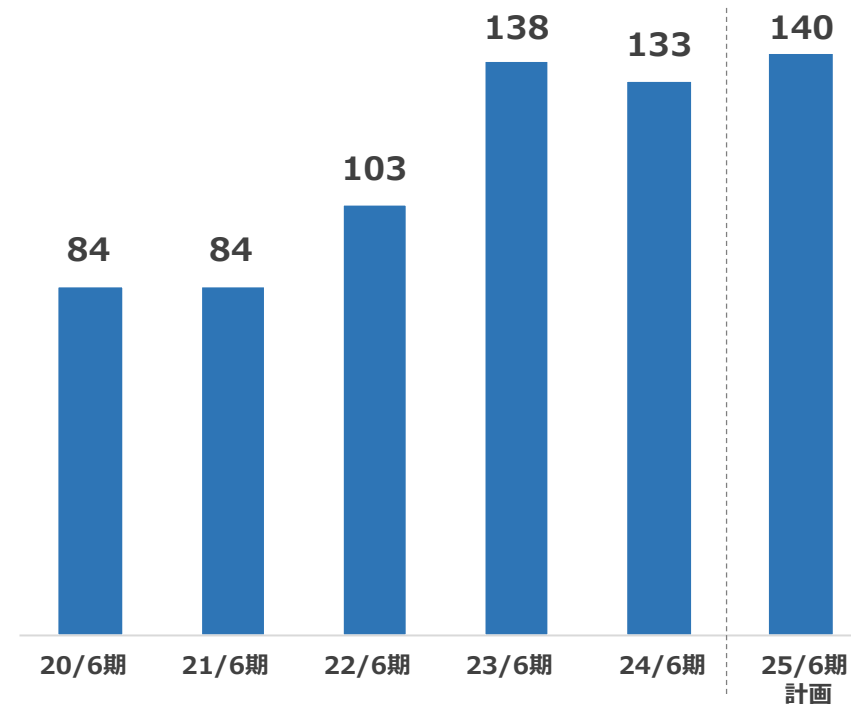
【単位：億円】

■ 建物・生産設備等  
■ 研究開発設備 ■ 減価償却費



## 研究開発費の推移・計画

【単位：億円】



## 社会的課題解決

スマート社会・  
デジタル社会実現グリーンエネルギー化  
低消費電力化

メモリ

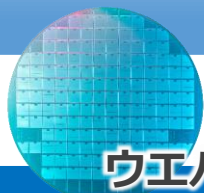
ロジック IC

センサー・電子部品

パワーデバイス

バッテリー

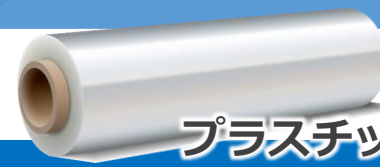
微細化 / 高性能化 / 低消費電力化



ウエハー



ガラス



プラスチック

## 真空薄膜形成技術

スパッタリング

蒸着

CVD

エッチング・アッシング

イオン注入

コンポーネント

マテリアル

カスタマーサポート

# さまざまな業界・用途で貢献する アルバックの真空技術



ULVAC